MANUFACTURE OF DIODE ELEMENT

Publication number: JP5190877
Publication date: 1993-07-30

Inventor:

TAO MOTOAKI; NICHOGI KATSUHIRO; NANBU TARO

Applicant:

MATSUSHITA GIKEN KK

Classification:

- international:

H01L51/05; H01L29/861; H01L51/05; H01L29/66;

(IPC1-7): H01L29/91

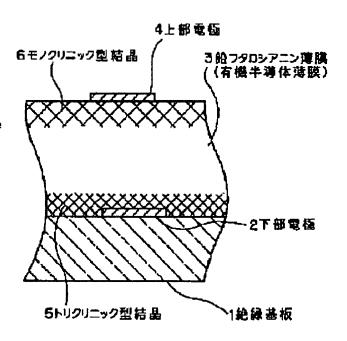
- European:

Application number: JP19910316710 19911129 Priority number(s): JP19910316710 19911129

Report a data error here

Abstract of JP5190877

PURPOSE:To provide a method for manufacturing a highly functional diode element which has a non-symmetrical structure utilizing an organic semiconductor, achieves a stable operation, and has a high withstand voltage in opposite direction. CONSTITUTION: A triclinic-type crystal 5 is formed at the side of a lower electrode 2 by performing vacuum deposition of lead phthalocyanine material while heating an insulation substrate 1 to 100 initially, a monochlinic-type crystal 6 is formed at the side of an upper electrode 4 by performing vacuum deposition by reducing the substrate temperature to a room temperature, and then an organic semiconductor thin film 3 in nonsymmetrical structure is formed on an insulation substrate 1 in thickness direction.

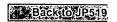


Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Family list

1 family member for: JP5190877

Derived from 1 application



1 MANUFACTURE OF DIODE ELEMENT

Inventor: TAO MOTOAKI; NICHOGI KATSUHIRO; Applicant: MATSUSHITA GIKEN KK

(+1)

EC: IPC: H01L51/05; H01L29/861; H01L51/05 (+2)

Publication info: JP5190877 A - 1993-07-30

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-190877

(43)公開日 平成5年(1993)7月30日

(51) Int.Cl.5

識別記号

FΙ

技術表示箇所

H01L 29/91

8225 - 4M

庁内整理番号

H01L 29/91

G

審査請求 未請求 請求項の数2(全 4 頁)

(21)出願番号 (22)出願日

特願平3-316710

平成3年(1991)11月29日

(71)出願人 390010021

松下技研株式会社

神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1

号

(72)発明者 田 尾 本 昭

神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1

号 松下技研株式会社内

(72)発明者 二 梃 木 克 洋

神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1

号 松下技研株式会社内

(72)発明者 南 部 太 郎

神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1

身 松下技研株式会社内

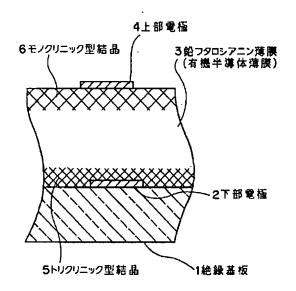
(74)代理人 弁理士 蔵合 正博

(54) 【発明の名称】 ダイオード素子の製造方法

(57)【要約】

【目的】 有機半導体を利用した非対称構造を有し、動作が安定し、逆方向の耐電圧が高い高機能性ダイオード 素子の製造方法を提供すること。

【構成】 鉛フタロシアニン材料を、絶縁基板1の温度を最初は100° Cにして真空蒸着することにより、下部電極2側にトリクリニック型結晶5を形成し、次いで基板温度を室温に下げて真空蒸着することにより上部電極4側にモノクリニック型結晶6を形成し、厚さ方向に非対称構造をとる有機半導体薄膜3を絶縁基板1上に形成する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁基板上に鉛フタロシアニンを基板温 度を変えて真空蒸着することにより、厚さ方向に非対象 構造をとる有機半導体薄膜を有するダイオード素子の製 **造方法。**

【請求項2】 絶縁基板上に下部電極を形成し、前記下 部電極を含む絶縁基板上に鉛フタロシアニンを430~ 440°Cの温度範囲で0.1~20オングストローム /秒の一定速度、かつ前記絶縁基板の温度を100°C 程度に保って真空蒸着し、次いで前記絶縁基板の温度を 10 室温に下げて同様にして鉛フタロシアニンを真空蒸着し て鉛フタロシアニン薄膜を形成し、前配鉛フタロシアニ ン薄膜の上に上部電極を形成してダイオード素子を形成 し、前記ダイオード素子を10-5 torrの真空中に5 時間程度放置することを含むダイオード素子の製造方

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、有機半導体薄膜を用い たダイオード素子の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、ダイオード素子についても高機能 化が要求され、その一つに逆方向の耐電圧が高いダイオ ード素子の実現が望まれている。このようなダイオード 素子を実現するために、有機半導体薄膜を利用したダイ オード素子が提案されている。有機半導体薄膜の両側を 単に電極で挟んだだけではダイオード特性が得られない ので、一方の電極側に絶縁層を設けて非対称構造とする こと等により、ダイオード特性を持たせている。例え て、アルミニウム電極に酸化膜を形成させることによ り、非対称構造で逆方向の耐電圧の高いダイオード素子 を得ていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 来の有機半導体薄膜を利用したダイオード素子では、絶 縁層の厚さやアルミニウム電極の酸化膜の厚さをうまく 制御することができないため、動作の安定した製品を得 ることが難しいという問題があった。

【0004】本発明は、このような従来の問題を解決す 40 るものであり、動作が安定した製品を得ることのできる 有機半導体薄膜を利用したダイオード素子の製造方法を 提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達 成するために、有機半導体薬膜自体を厚さ方向に非対称 構造とするために、絶縁基板上に鉛フタロシアニンを基 板温度を変えて真空蒸着するようにしたものである。

[0006]

【作用】したがって、本発明によれば、絶縁基板上に鉛 50 蒸着原料として市販の鉛フタロシアニンを真空中で3回

フタロシアニンを基板温度を変えて真空蒸着することに より、有機半導体薄膜自体を厚さ方向に非対称構造とす ることができ、動作の安定した逆方向の耐電圧の高いダ イオード素子を容易に製造することができる。

[0007]

【実施例】以下、本発明の実施例について説明する。図 1は本発明の一実施例におけるダイオード素子の断面構 成を示している。図1において、1は絶縁基板、2はそ の表面の一部に設けられた下部電極、3は下部電極2を 覆うように絶縁基板1の上に設けられた有機半導体薄膜 である鉛フタロシアニン薄膜、4は鉛フタロシアニン薄 膜3の上に設けられた上部電極である。

【0008】このように、上記ダイオード素子は、鉛フ タロシアニン薄膜3を間にしたサンドイッチ電極型構成 をとっている。鉛フタロシアニン薄膜3は、真空蒸着法 で形成された薄膜であり、下部電極2側の結晶はトリク リニック型結晶 5、上部電極 4 側の結晶型はモノクリニ ック型結晶 6 からなり、このような結晶構造によりダイ オード特性を示している。

【0009】鉛フタロシアニンを原料として、蒸着源温 20 度を400~550°Cの範囲で制御して、蒸着速度を 0. 1~20オングストローム/秒の間で一定速度で真 空蒸着を行なうと、薄膜の厚さ方向に、膜裏面側がトリ クリニック型結晶、膜表面側がモノクリニック型結晶か らなる非対称な構造をとる有機半導体薄膜ができる。よ り具体的には、蒸着中の基板温度を変化させることによ り鉛フタロシアニンの結晶型を制御することができ、基 板温度を室温にするとモノクリニック型、約100°C にするとトリクリニック型薄膜となる。すなわち、最 ば、一方の電極を金、他方の電極にアルミニウムを用い 30 初、絶縁基板1の温度を約100°Cに保持して鉛フタ ロシアニンを蒸着することにより、下部電極2側にトリ クリニック型結晶5を形成し、引き続き絶縁基板1の温 度を室温にして鉛フタロシアニンを蒸着することによ り、上部電極4個にモノクリニック型結晶6を形成し て、薄膜の厚さ方向に非対称な構造をとる鉛フタロシア ニン薄膜3を形成する。そして、このような鉛フタロシ アニン薄膜3を電極2,4で挟んでダイオード素子を構 成すると、電極2, 4との界面のパリアの状態が変わる ため、ダイオード特性を示すようになる。

> 【0010】以下、上記実施例におけるダイオード索子 の製造方法について、図2を参照してさらに詳しく説明 する。まず、絶縁基板1として縦35mm、横25m m、厚さ1mmの石英ガラスをトリクロロエタン、アセ トン、イソプロピルアルコールを順に使って超音波洗浄 したものを用いた (ステップ11)。次にこの絶縁基板 1の表面に金を蒸着し、下部電極2を幅1mm、厚さ5 00オングストロームで形成した(ステップ12)。

【0011】続いて、電極形成面側に鉛フタロシアニン 薄膜3を以下のようにして形成した(ステップ13)。

繰り返し昇華精製したものを石英のるつぼに入れ、抵抗 加熱により430~440° Cの範囲で調整し、蒸着速 度1オングストローム/秒と一定に保ちながら厚さ10 0オングストロームの膜を基板温度を100°Cに保っ た絶縁基板1上に形成した。さらに、真空中で基板温度 を室温に下げた後、蒸着速度1オングストローム/砂で 引き続き厚さ1μmの膜を絶縁基板1上に形成した。

【0012】次いで、鉛フタロシアニン薄膜3の表面 に、金を蒸着し、上部電極4を幅1mm、厚さ500オ ングストロームで下部電極2と直交するように形成した 10 造することができる。 (ステップ14)。この素子を10-5 torrの真空容 器内に5時間放置して真空処理し(ステップ15)、次 いで真空容器内から取り出して両電極2、4に金線をイ ンジウムで接合し、リード線を取り出してダイオード素 子を完成した(ステップ16)。

【0013】完成したダイオード素子の鉛フタロシアニ ン薄膜3における下部電極2側の結晶はトリクリニック 型結晶6であり、上部電極4側の結晶はモノクリニック 型結晶5であった。

【0014】次に、このようにして製造したダイオード 20 素子の動作を、図3に示す測定回路を用いて調べた。図 3において、7は測定対象となるダイオード素子であ り、8はダイオード素子7に電界をかけるための電源で あり、印加電界は電圧計9で測定し、ダイオード素子7 を流れる電流は電流計10で測定した。

【0015】まず、図2のステップ15の真空処理する 前のダイオード素子に対して、上部電極4側に対し下部 電極2側が正となる向きで薄膜方向に電界を印加する と、図4に示すように、鉛フタロシアニン薄膜3が高抵 抗状態から低抵抗状態に変化するスイッチ動作が起こ 30 【符号の説明】 る。次に電界を小さくしても低抵抗状態が保たれる。し かしながら、逆方向の電界を印加すると、電流は殆ど流 れずダイオード特性を示すことがわかる。

【0016】続いて、このダイオード素子をステップ1 5 で真空処理することにより、高抵抗状態と低抵抗状態 の間のスイッチ動作が小さくなり、状態変化を示さなく なる。このように真空処理したダイオード素子の動作を 図3に示す測定回路を用いて調べた結果、図5に示すよ うに、逆方向の耐電圧が50Vのダイオード特性を示し

【0017】このように、上記実施例によれば、有機半 導体薄膜として鉛フタロシアニン薄膜を真空蒸着法によ り基板温度を変えて形成したので、有機半導体薄膜自体 を容易に非対称構造とすることができ、動作の安定した 逆方向の耐電圧の高いダイオード素子を極めて容易に製

[0018]

【発明の効果】以上に述べたように、本発明によるダイ オード素子の製造方法は、鉛フタロシアニン薄膜を真空 蒸着法により基板温度を変えて形成したので、厚さ方向 に非対称構造の有機半導体薄膜を容易に形成することが でき、動作の安定した逆方向の耐電圧の高い優れた特性 を有するダイオード素子を容易に製造することができ

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例におけるダイオード素子の構 成を示す部分断面図

【図2】同ダイオード素子の製造方法の一実施例を示す フローチャート

【図3】同ダイオード素子の動作を調べるための測定回 路図

【図4】同ダイオード素子の真空処理前の印加電界(電 圧) - 電流特性を示す図

【図5】同ダイオード素子の真空処理後の印加電界(電 圧) -電流特性を示す図

- 1 絶縁基板
- 2 下部電極
- 3 鉛フタロシアニン薄膜(有機半導体薄膜)
- 4 上部電極
- 5 トリクリニック型結晶
- 6 モノクリニック型結晶

【図3】

